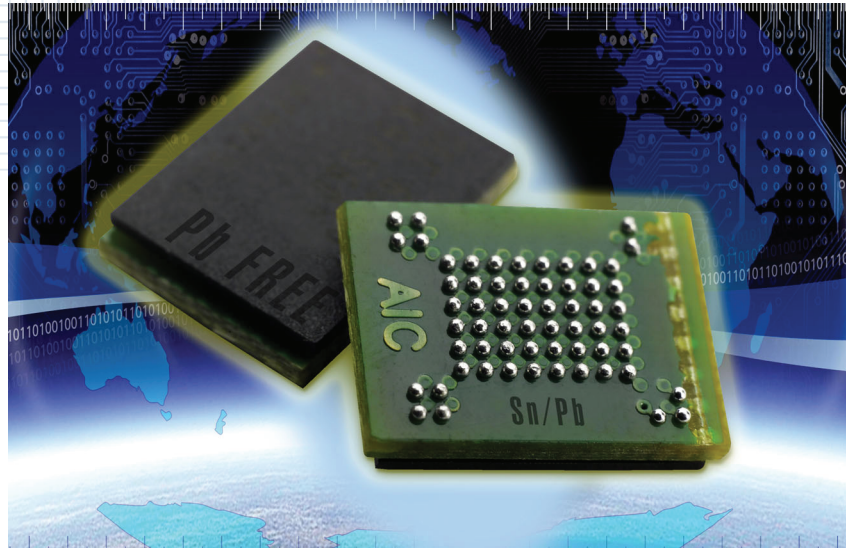


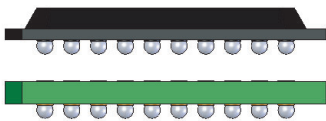
# 由无铅转成 - 锡/铅的 BGA 转介器

Advanced Interconnections公司最新的BGA转介器提供了一个高效益的方案，将无铅工艺的BGA封装，转化成可用在比较低温及有铅的焊接工序。

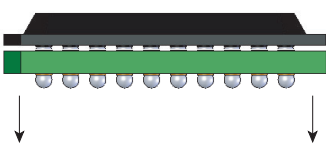
Advanced公司这款转介器是为不受RoHS限制的应用而设计的。这方案可解决BGA器件过度和停产的问题，及无铅BGA封装需要高温处理所带来的困难。



## 产品装配



▶ Advanced 公司可将无铅的BGA器件经高温工序焊接到转介器上，



▶ 转介器（连BGA器件）可使用现有的锡/铅焊接工序焊接到电路板上。

电路板

▶ Advanced公司产前准备方案包括：提供将无铅BGA元件经高温焊接到转介器的服务，接着是在转介器底部种上(63Sn/37Pb) 焊锡球。\*

▶ 如需要报价，请提供器件的规格，以及采购数量。

\* BGA 元件可由客户提供或由Advanced 公司代为寻找和提供。

## 特性

- Advanced 公司所供应已焊上无铅BGA的转介器可随时用在现成的PCB上
- 转介器的尺寸与原BGA器件非常接近，且物料为高温，耐热的FR-4。不用将有铅焊接工序改至无铅工序，也无需不必要地令其他元件处于高温工序
- 转介器用上业界已确认的可溶性焊锡球（63Sn/37Pb）可提供与原BGA（有铅）无异的可靠焊接效果
- 在工厂（高温焊接）无铅BGA 器件已焊接完成
- 转介器与BGA元件的引脚相同（现有间距：0.80, 1.00 和1.27mm）
- 标准的盘装；或卷带包装可供选择

工业实践证明可溶性焊锡球（63Sn/37Pb）可提供高可靠性，相当于含锡/铅的BGA封装的焊接

## 典型应用

- 医疗、军事和其他免于RoHS要求的产品
- 电路板上对温度很敏感的元器件
- 有铅BGA器件停产

